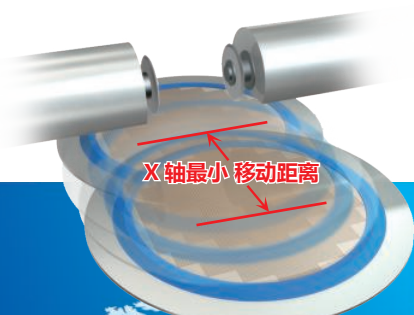


AD3000T-PLUS

快速, 精准, 创新



X轴最小 移动距离

对向型双轴机

占地面积非常小

使用本公司核心技术
占地面积大大减小
是原来机型的 68%

实现快速加工

X 轴 1000mm/s
Y 轴 300mm/s
加工速度快、使用成本低

进化的 GUI 操作界面

双轴机上搭载 GUI 技术
标准配置 HELP 功能

维护便捷

大型的前部维护门
更方便进行日常的维护

东京精密自 1970 年开发了第一台晶圆切割机 A-WD-75A 以来, 为高精度芯片分割和半导体产业开始时期的高效率化做出了很大的贡献。

继承开发当初的技术的基础上, 融合了最新的 Fluidics ·

Mechatronics · Energy Conservation 技术的 AD3000T-PLUS,
正引领新的切割技术。

特 征

1 选配单元的小型化，内部设计的优化，使得主要选配单元内藏成为可能。

2 标准搭载6万转的主轴
(8万转选配可对应)

3 加工效率提高

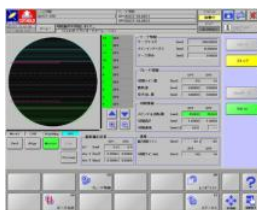
- ① X轴速度 1000 mm/s, Y轴速度 300 mm/s, Z轴速度 80 mm/s
② 搭载2个光学式测高单元

4 17英寸触摸屏 + 新GUI

搭载了GUI(用户操作界面)，易于观察的画面和大型的按钮，在增强操作性的同时，采用了对话式的容易理解的输入方式

5 维护性向上

大型的前部维护门提高了维护的便利性



▲ 新 GUI

充实的 option

1 磨刀工作台

可搭载2片75 mm×75 mm尺寸的磨刀板。
各主轴上的刀片可使用专用磨刀板进行修磨。

2 可搭载 Air micron 单元

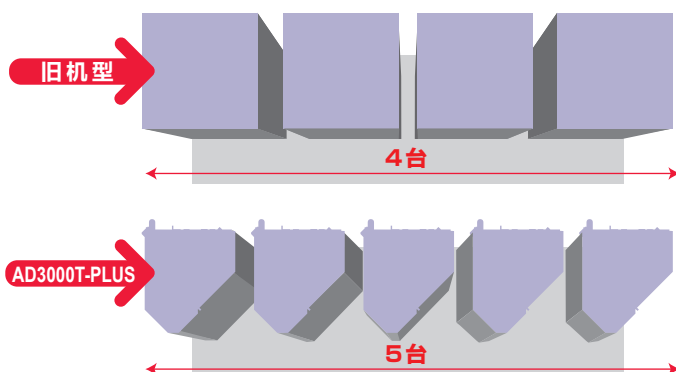
非接触式测量胶带的厚度和工件的厚度。
精确控制加工高度，实现高精度切割

3 高精度控制加工高度

加工中X/Y/Z轴同时控制，可对工件高度的起伏进行追踪，
实现高精度加工。

安装空间

AD3000T/AD3000T-PLUS 与旧机型(A-WD-300TX)相比，成功实现了小型化。



维 护



规 格

最大工件尺寸		φ 305 mm
最大框架尺寸		12 英寸 (SEMI G74-0699)
主轴	最高转速	60,000 min-1
		最大刀片外径
	最大刀片外径	60,000 min-1 80,000 min-1 (选配)
	输出功率	1.8 KW
X 轴	可切割范围	310 mm
	最高速度	1,000 mm/s
Y1/Y2 轴	可切割范围	310 mm
	最高速度	300 mm/s
	分辨率	0.078 μm
	精度	0.002 mm / 310 mm
Z1/Z2 轴	行程范围	35 mm
	分辨率	0.002 μm
	最高速度	80 mm/sec
	重复精度	0.001 mm
θ 轴	旋转范围	380°
使用条件	电压	3 相 AC200 to 220± 10% (可使用变压器)
	功率	6.0 kVA (MAX)
	气压	0.55 ~ 0.7 MPa
	平均气体消耗量	210 L/min (0.55 MPa)
	平均洁净气体消耗量	140 L/min
	切割水和其他 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	切割水和其他 (最大流量)	切割水 : 10.0 L/min 水帘 : 3.0 L/min 其他 : 0.6 L/min
	冷却水 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	冷却水 (最大流量)	3.4 L/min (0.3 MPa)
	排气量	5.0 m3/ min 以上
尺寸 (W*D*H)		1,290 mm x 1,530 mm x 1,900 mm
重量		1,360 kg